

2021年度(2022年3月期) 第2四半期決算概要について



Brightening the Future
Since 1946

2021年度 第2四半期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

2021年度 通期の見通し（連結）

業績予想の修正（10/26付）	11
売上高・損益・配当	12

2021年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

設備投資額・減価償却費・研究開発費	14
成長市場向け設備投資の実施について （2021年10月4日付リリース）	15

決算概況

（単位：億円）

	2020年度 2 Q累計	2021年度 2 Q累計	前年同期比		予想比	
				増減率	7/29予想	増減
売上高	845	1,259	+415	49%	1,216	+43
営業利益 （営業利益率）	72 (9%)	301 (24%)	+228	315%	268	+33
経常利益 （経常利益率）	83 (10%)	316 (25%)	+232	278%	276	+40
純利益※ （純利益率※）	56 (7%)	217 (17%)	+161	290%	188	+29

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	41.25円	160.71円
-------------	--------	---------

© 2021年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用

売上高：

- 半導体業界は、社会・経済におけるデジタル化の急速な進展等を背景に、パソコンやサーバーをはじめ幅広い分野において需要が大きく拡大し、自動車市場向け等において半導体の需給逼迫が顕在化するなど、旺盛な需要環境が継続。

当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージ、リードフレーム、セラミック静電チャックなどの売上が大きく増加し、前年同期比49%増と大幅な増収。

損益：

- 旺盛な需要を背景とする各製品の売上増加に伴う収益性の向上や、為替相場が円安基調で推移したことなどにより、前年同期比で大幅な増益。

▶ **売上高、各利益とも過去最高となりました。**

セグメント別売上高・経常利益

(単位：億円)

セグメント		2020年度 2Q累計		2021年度 2Q累計		前年同期比 増減率 (%)	2020年度	
			構成比(%)		構成比(%)			構成比(%)
売上高 ※1	プラスチックパッケージ	513	(61)	793	(63)	55	1,133	(60)
	メタルパッケージ	294	(35)	424	(34)	44	664	(35)
	その他	38	(4)	43	(3)	13	83	(5)
	合計	845	(100)	1,259	(100)	49	1,881	(100)
経常利益 ※2	プラスチックパッケージ	54	(11)	228	(29)	323	170	(15)
	メタルパッケージ	31	(10)	88	(21)	187	91	(14)
	その他/調整額	△1		△1			4	
	合計	83	(10)	316	(25)	278	265	(14)

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

参考情報

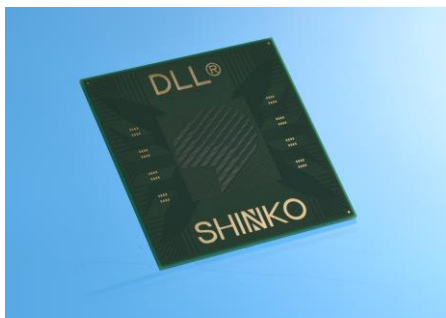
(単位：億円)

	2020年度 2 Q	2021年度 2 Q	2020年度
総 資 産	2,217	2,696	2,410
純 資 産	1,416	1,726	1,534
自己資本比率	64%	64%	64%

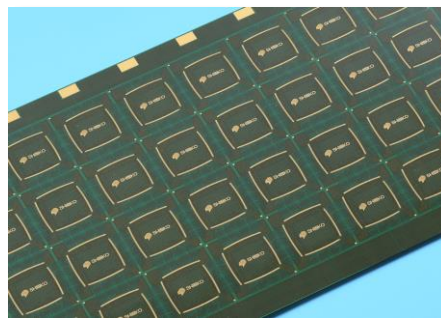
設備投資額 ※	103	371	301
減価償却費 ※	65	115	174
研究開発費	14	17	30
為替レート(1米ドル)	105円	108円	105円

※ 無形固定資産を除く

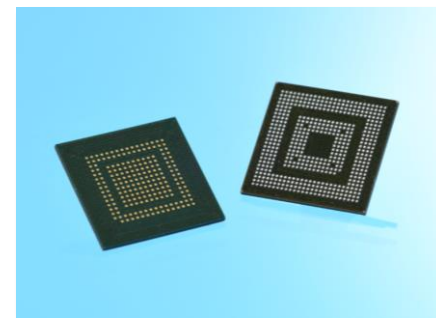
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

プラスチックパッケージ

（単位：億円）

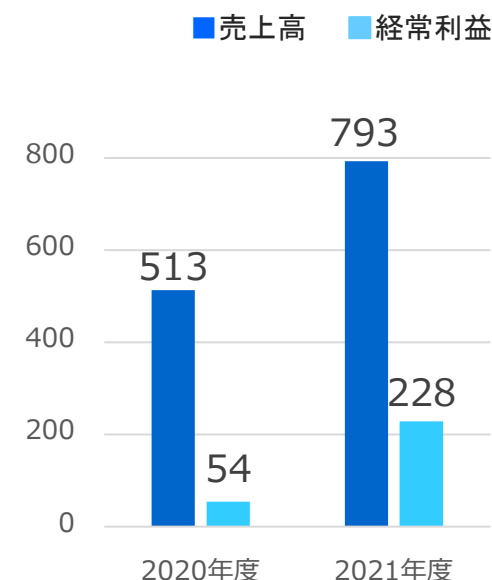
	2020年度 2 Q 累計	2021年度 2 Q 累計	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高（構成比）	513（61%）	793（63%）	+280	55%
経常利益（利益率）	54（11%）	228（29%）	+174	323%

<売上高>

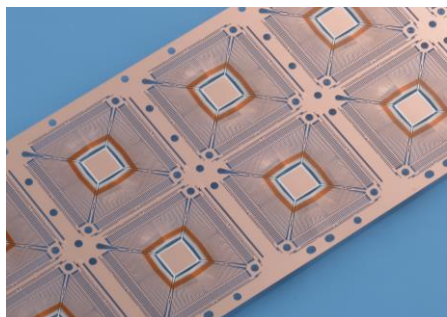
- フリップチップタイプパッケージは、パソコン、サーバー向けの需要拡大継続により売上が大幅に増加
- IC組立は、ハイエンドスマートフォン向けに受注が増加
- プラスチックBGA基板は、先端メモリーや自動車向けの受注が高い水準で推移

<損益>

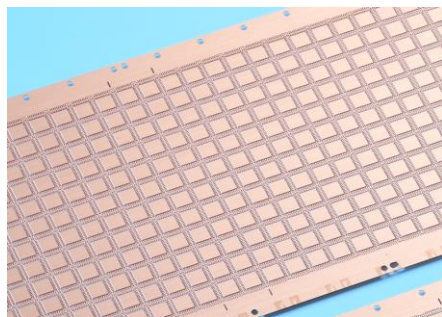
- フリップチップタイプパッケージの売上が高付加価値製品をはじめ大きく増加し、為替相場が円安基調で推移したことなどにより、大幅増益



メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

メタルパッケージ

（単位：億円）

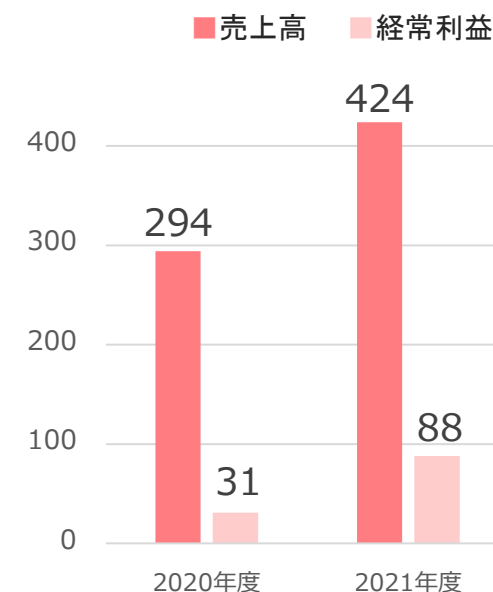
	2020年度 2 Q 累計	2021年度 2 Q 累計	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高（構成比）	294（35%）	424（34%）	+130	44%
経常利益（利益率）	31（10%）	88（21%）	+57	187%

<売上高>

- リードフレームは、昨年、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた自動車市場の回復に加え、幅広い用途において需要が増加したことを背景に大幅な増収
- セラミック静電チャックは、半導体製造装置市場における旺盛な需要に支えられ売上が大きく増加
- ガラス端子は、光学機器向けに受注が回復
- CPU向けヒートスプレッダーは、前年並み

<損益>

- リードフレーム、セラミック静電チャックの増収効果、為替相場が円安基調で推移したことなどにより、大幅増益



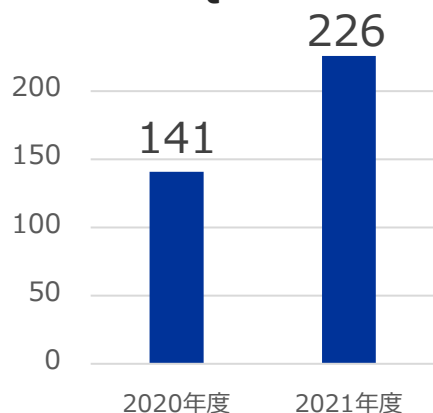
部門別売上高

（単位：億円）

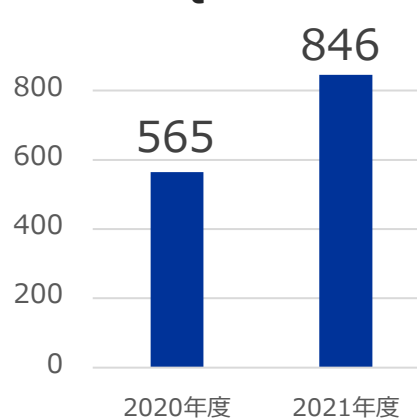
部 門	2020年度 2 Q累計	2021年度 2 Q累計	前年同期比		2020年度
				増減率	
ICリードフレーム	141 (17%)	226 (18%)	+85	61%	334 (18%)
ICパッケージ	565 (67%)	846 (67%)	+281	50%	1,231 (65%)
気密部品	138 (16%)	188 (15%)	+49	36%	314 (17%)

※（ ）は構成比

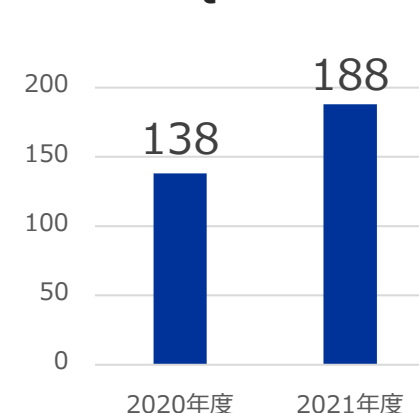
ICリードフレーム部門
2Q 売上高



ICパッケージ部門
2Q 売上高



気密部品部門
2Q 売上高



通期業績予想の修正（2021/10/26付）

（単位：億円）

	2021年度通期			
	前回予想 (7/29)	今回予想 (10/26)	増減額	増減比
売上高	2,420	2,642	222	9%
営業利益	406	594	188	46%
経常利益	395	614	219	55%
純利益※	269	424	155	58%
1株当たり当期純利益	199.13円	313.86円	—	—

※親会社株主に帰属する当純利益

修正理由（要旨）

- 半導体市場は、需要拡大が続き、引き続き好調に推移することが見込まれる。
- 第2四半期は、フリップチップタイプパッケージ等が好調に推移したことなどにより想定を上回る売上・収益となった。
- 第3四半期以降、製品構成の変化などを背景にフリップチップタイプパッケージの売上減少を想定していたが、旺盛な需要が継続し、売上は想定を上回ることが見込まれる。
- セラミック静電チャックは半導体市場の拡大を背景に需要がさらに増加し、IC組立はハイエンドスマートフォン向けに受注増となるなど、各製品の売上増加が見込まれる。
- これらにより、売上・収益ともに想定を上回り、高付加価値製品をはじめとする売上増加による収益性の向上や、為替相場が円安傾向で推移していることなどにより、特に収益面において想定を大きく上回ることが予想されることから、7月29日公表の通期業績予想数値を修正。
- 通期業績予想の前提となる第3四半期以降の為替レートを1米ドル=105円から108円に変更。

売上高・損益・配当

(単位：億円)

	2020年度 (実績)			2021年度 (上期実績・下期予想)			前期比 (上段：増減金額、下段：増減比率)		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上高	845	1,036	1,881	1,259	1,383	2,642	415 (49%)	347 (33%)	761 (40%)
営業利益 (営業利益率)	72 (9%)	161 (16%)	233 (12%)	301 (24%)	293 (21%)	594 (22%)	228 (315%)	133 (82%)	361 (155%)
経常利益 (経常利益率)	83 (10%)	182 (18%)	265 (14%)	316 (25%)	298 (22%)	614 (23%)	232 (278%)	117 (64%)	349 (132%)
純利益※ (当期純利益率※)	56 (7%)	124 (12%)	180 (10%)	217 (17%)	207 (15%)	424 (16%)	161 (290%)	82 (66%)	244 (135%)
為替レート	105円/\$			108円/\$	108円/\$				

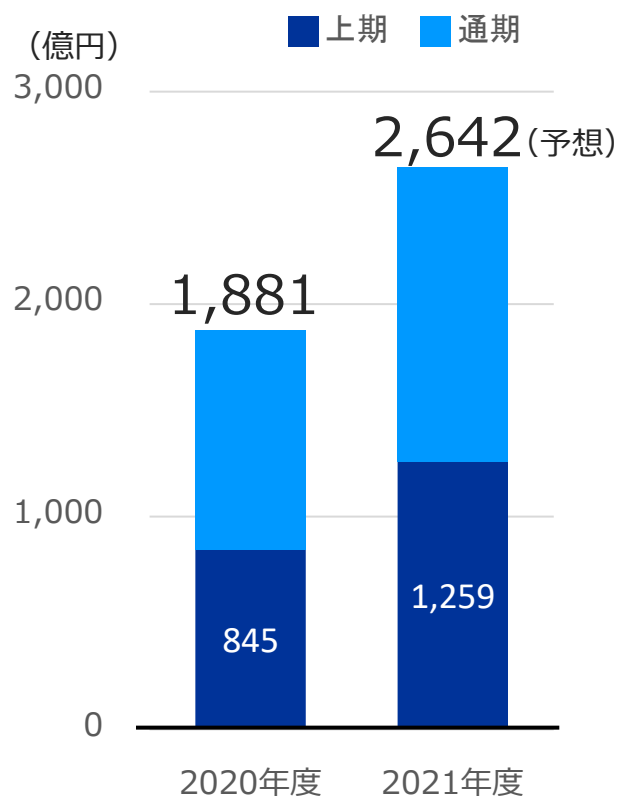
※ 親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：円)

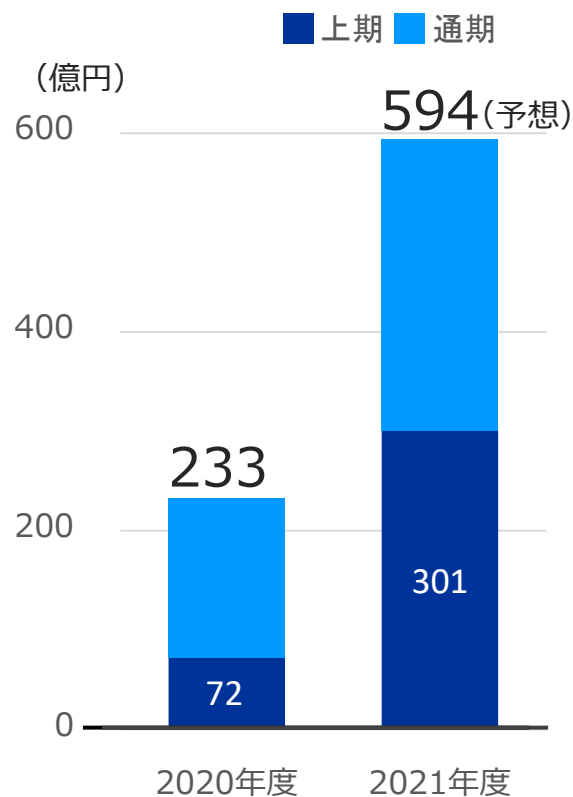
1株当たり配当金 (配当性向)	12.5 [中間]	17.5 [期末]	30.0 (22%)	17.5 [中間]	17.5 [期末]	35.0 (11%)
--------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

2021年度 通期の見通し (連結)

売上高

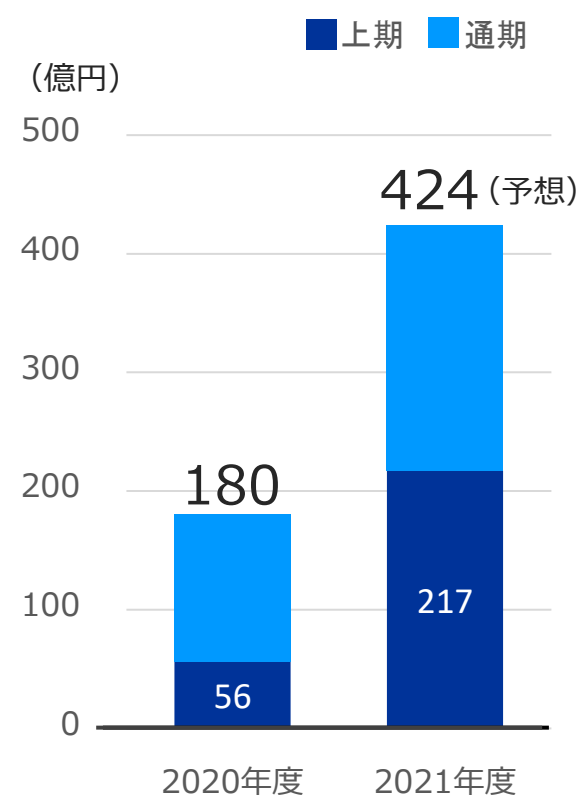


営業利益

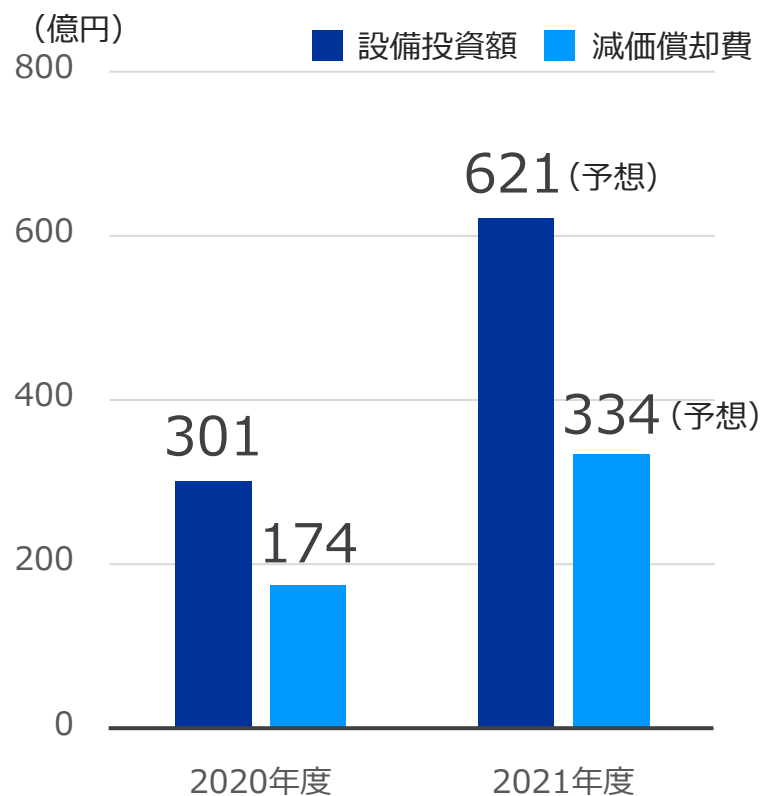


純利益※

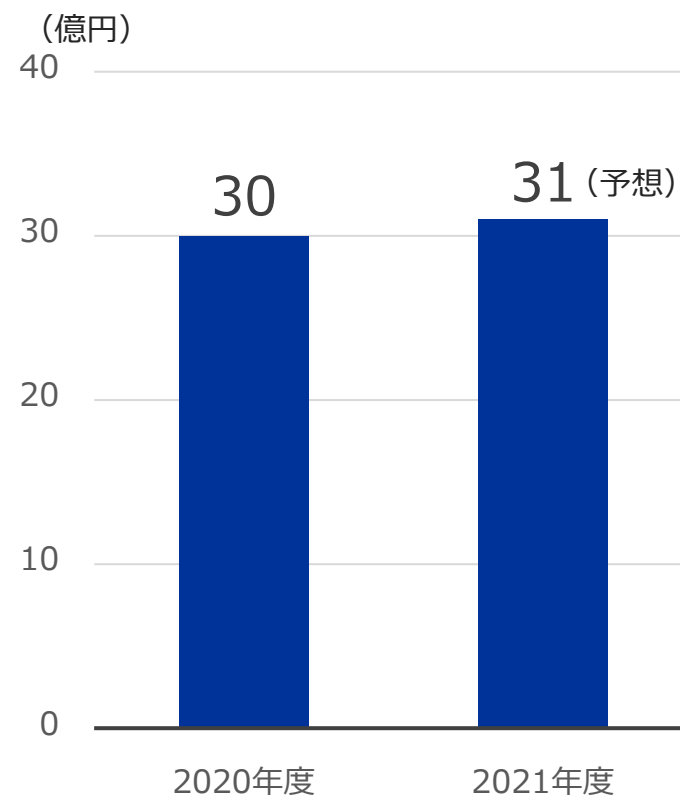
※親会社株主に帰属する当期純利益



設備投資額・減価償却費



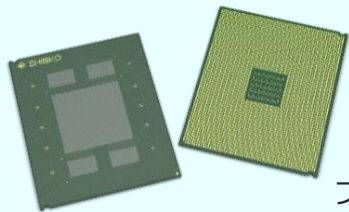
研究開発費



半導体市場における今後の需要拡大に対応するため、パソコンやサーバーなどに搭載されるCPU等の高性能半導体向けフリップチップタイプパッケージの生産体制強化を目的として、生産拠点の新設等設備投資を実施するとともに、半導体製造装置向けセラミック静電チャックの生産能力増強をはかるため、当社高丘工場内に新棟建設を計画しております。

【フリップチップタイプパッケージの生産体制強化】

- (1) 投資内容：生産拠点の新設
更北・若穂工場の生産能力増強
- (2) 投資額：2022～2025年度投資額計 1,400億円
- (3) 生産能力：現行比約50%程度増強
- (4) 新拠点の概要(予定)：
 - ① 所在地 長野県千曲市
 - ② スケジュール 2022～2023年度 建設工事
2024年度以降 順次稼働



フリップチップタイプパッケージ

【セラミック静電チャックの生産能力増強】

- (1) 投資内容：新棟建設（高丘工場内）
- (2) 投資額：2021～2023年度投資額計 180億円
- (3) 生産能力：既存棟における着手済投資分を含め
現行比約2倍程度に増強
- (4) 新棟の概要（予定）：
 - ① 所在地 高丘工場内（長野県中野市）
 - ② 建物構造 鉄骨造5階建、延床面積28千㎡
 - ③ スケジュール 2021年12月 着工
2023年3月 竣工
2023年度下期 稼働開始



セラミック静電チャック

※本設備投資は、2023年度より順次稼働を開始することを予定しているため、本設備投資計画による2022年3月期連結業績に与える影響は軽微であります。

※本投資計画の詳細は2021年10月4日発表の「成長市場向け設備投資の実施について」をご覧ください。

https://www.shinko.co.jp/news/docs/20211004_01.pdf

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。